微电子封装技术



作者: 中国电子学会生产技术学分会丛书编委会组编

出版社: 合肥: 中国科学技术大学出版社

出版日期: 2003.04

总页数: 314

介绍:本书全面系统地论述了在晶体管和集成电路发展的不同历史时期出现的典型微电子封装技术,着重论述了当前应用广泛的先进IC封装技术。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/11132291.html) 查找全本阅读方式

微电子封装技术 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/11132291.html 教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/11132291.html

书名: 微电子封装技术